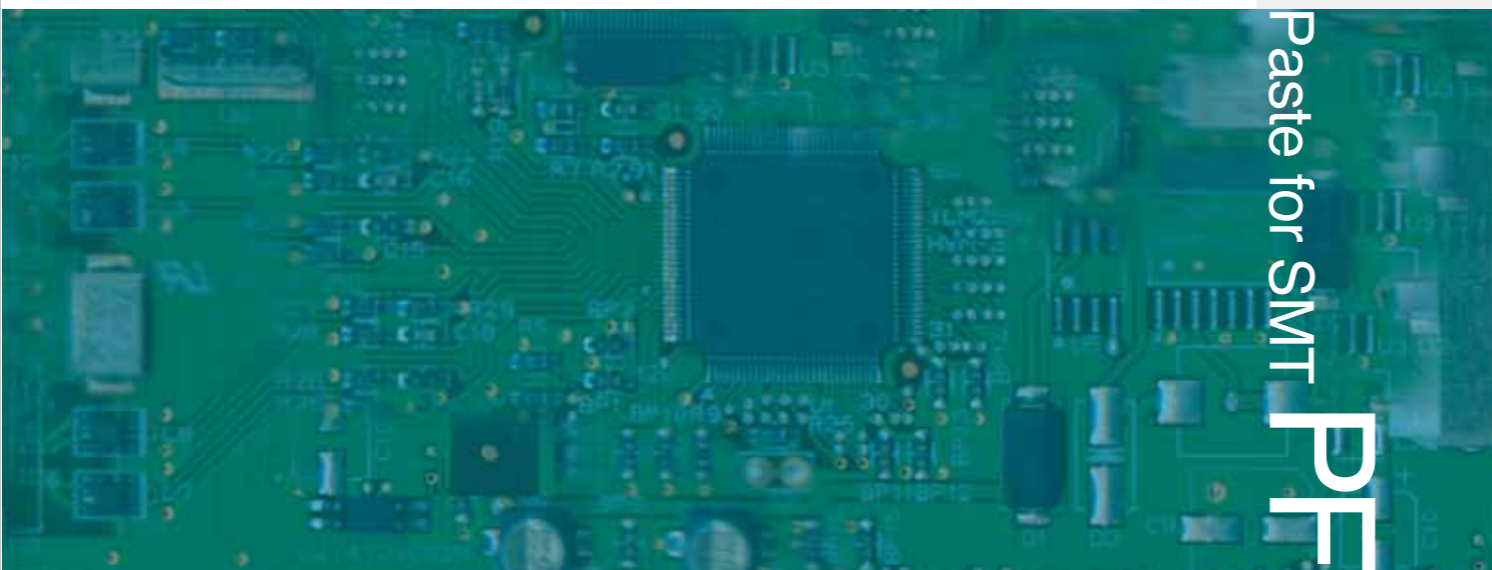


PF142-LT7T0

SMT用低融点鉛フリーソルダペースト

ハロゲンフリータイプ

- ハロゲンフリーでありながら良好なぬれ性。
Good wettability even by the halogen free.
- 低温リフローでも優れたはんだ付け特性。
The excellent solderability with low temperature reflow.



● 一般特性 General characteristics

項目 Items	代表特性 Typical Property	試験方法 Test method
合金組成 Alloy composition	Sn-57Bi-1Ag	-
粒度 Particles Size	20~38 μm	-
フラックス含有量 Flux content	10.0%	JIS Z 3197
ハロゲン含有量 Halide content(chlorine conversion)	0.02%	配合値 Blend Value
銅板腐食試験 Copper plate corrosion test	Pass	JIS Z 3284
クロム酸銀試験 Silver chromate paper test	Pass	JIS Z 3197
銅鏡試験 Copper mirror test	Pass	JIS Z 3197
絶縁抵抗試験 Electric insulation resistance test, SIR	40°C90%RH	1.0×10 ¹² Ω
	85°C85%RH	1.0×10 ¹⁰ Ω
100g以上粘着保持時間 Tackiness time of keeping 100g (50kN/m ²) minimum	8 hours	JIS Z 3284
流動特性 Fluidity	粘度 Viscosity	185 Pa·s
	Ti値 Thixotropic index	0.52

上記特性値は代表値で保証値ではありません。The physical property values of above are not the specification of the product.

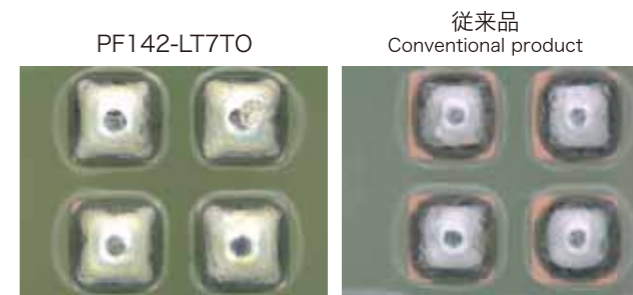
PF142-LT7T0

SMT用低融点鉛フリーソルダペースト

ハロゲンフリータイプ

ハロゲンフリーでありながら良好なぬれ性
Good wettability even by the halogen free

電子機器における
ハロゲンフリーの要求
The electronic applications required
for halogen free.
塩素 (Cl) < 900 ppm
臭素 (Br) < 900 ppm
合計 Total < 1500 ppm

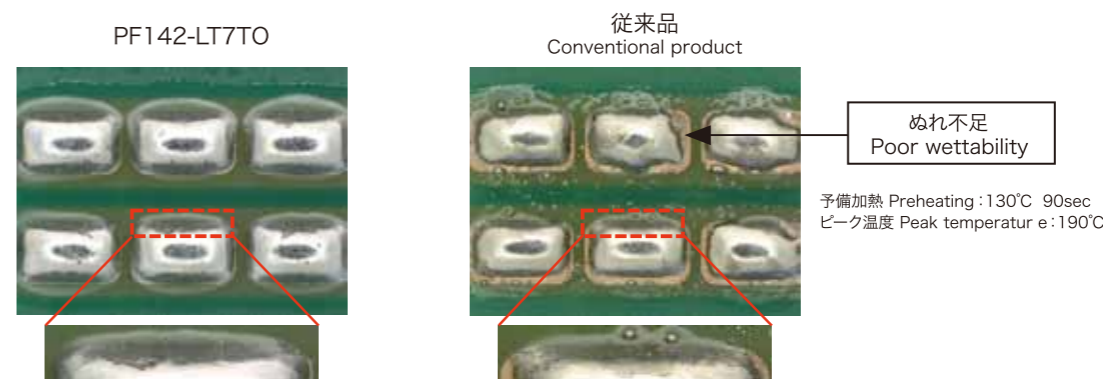


予備加熱 Preheating : 120~130°C 90sec
ピーク温度 Peak temperature : 190°C

良好なぬれ性
Good wettability

ぬれ不足
Poor wettability

低温リフローでも優れたはんだ付け特性
The excellent solderability with low temperature reflow



良好なはんだ付け性
Good solderability

はんだボール発生
Solder ball

ぬれ不足
Poor wettability

予備加熱 Preheating : 130°C 90sec
ピーク温度 Peak temperature : 190°C



はんだボール発生なし
No solder ball
透明なフラックス残渣
The transparent residue

はんだボール発生
Solder ball

試験基板 Test board :セラミック板 Ceramics
予備加熱 Preheating : 130°C 90sec
ピーク温度 Peak temperature : 190°C